

RESINES EPOXY ELECTROCONDUCTRICES, BICOMPOSANT*

REF	RAPPORT MELANGE	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
								AVANT TG	APRES TG		
E201	2/3	5 min à 150°C	8 h à 25°C	3 Pa.s	70-80°C	380-400°C	71,5%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage du silicium sur grille dans la fabrication des semi-conducteurs
E202	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	1 Pa.s	70-80°C	380-400°C	72%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage du silicium sur grille dans la fabrication des semi-conducteurs - Faible taux de volatile - Dépose de gouttes de petite dimension
E203	1/1	25 min à 150°C	8 h à 25°C	2 Pa.s	40-50°C	330-400°C	79%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	100-120.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage sur claviers souples en polyester - Résine souple
E204	1/1	5 min à 150°C	8 h à 25°C	0,75 Pa.s	70-80°C	380-400°C	74,5%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	170-1800.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Résine liquide
E205	1/1	3 min à 150°C	8 h à 25°C	2 Pa.s	70-80°C	390-400°C	71,5%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	100-120.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage circuits polyesters - Réticulation basse température
E206	10/0,8	10 min à 100°C	1 h à 25°C	8 Pa.s	40-50°C	> 350°C	55%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<10 mΩ.cm	Collage de fils dorés sur électrodes
E207	10/0,2	48 h à 25°C	6 h à 25°C	3,5 Pa.s	80-100°C	> 350°C	76,5%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	0,3 mΩ.cm	Bonne conduction électrique après réticulation ambiante - Conforme norme ESA PSS-01-702
E212	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	1,5 Pa.s	80-90°C	350-370°C	71%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	150-180.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Sérigraphiable
E212LF	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	25 Pa.s	70-80°C	380-410°C	70%	55-65.10 ⁻⁶ /°C	100-110.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de condensateurs tantale
E212M	1/1	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	0,8 Pa.s	70-80°C			50-60.10 ⁻⁶ /°C		<0,5 mΩ.cm	Collage de puces en silicium - Sérigraphiable - Plus fluide que la E212
E212M-1	100/2	5 min à 150°C	1 jour à 25°C	3 Pa.s	70-90°C	390-410°C		40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Sérigraphie de pistes conductrices ou de plages d'accueil pour le report de puces - Très bonne définition en sérigraphie
E215	2/1	5 min à 100°C	4 h à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	390-410°C	73%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Application cartes à puces - Bonne définition en sérigraphie - Réticulation très rapide
E300	1/1	1 h à 200°C	8 h à 25°C	500 Pa.s	60-80°C	350-360°C		80-90.10 ⁻⁶ /°C	430-450.10 ⁻⁶ /°C	10 à 15 Ω.cm	Résine faible coût - Chargée graphite
E301	1/1	24 h à 20°C	1 jour à 25°C	500 Pa.s	70-90°C	350-360°C		80-90.10 ⁻⁶ /°C	430-450.10 ⁻⁶ /°C	2500 Ω.cm	Réticulation à basse température - Chargée graphite

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 24/04/2006

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com